

RJ45C5 T1V 4.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamme de produit comprend les conceptions suivantes :

- 90°, couché (horizontal) et 180°, debout (vertical)
- verrouillage / déverrouillage
- Systèmes de soudure THT, THR ou SMD
- Large gamme de formes, également avec des LED intégrées et des languettes de contact blindage
- Catégorie de puissance Cat. 3 à Cat. 6
- Version emballée sur plateau (TY) ou en rouleau (Tape-on-Reel, RL)
- Compatible avec le connecteur modulaire RJ45, selon ANSI / TIA-1096-A et CEI 60603
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC RMS (2250 V AC valeur crête) selon IEEE 802.3
- Rigidité diélectrique ≥ 1500 V AC (valeur crête) ou ≥ 1500 V DC selon CEI 60603

Propriétés et avantages :

- Plage de température étendue de -40 °C à $+85$ °C pour une puissance maximale
- Couche d'or renforcée (30μ "") pour une protection contre la corrosion améliorée
- Une distance minimale de 0,3 mm garantit une soudure parfaite

Informations générales de commande

Version	Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45, Connecteur pour circuit imprimé, Cat. 5, Raccordement soudé THT, 180°, aucun, Non, Cycles d'enfichage: 750, Nombre de pôles: 8, PA 6T, 30...80 μ " Ni / ≥ 30 μ " Au, Tablette (assemblage à la main)
Référence	2436450000
Type	RJ45C5 T1V 4.0N4N TY
GTIN (EAN)	4050118448832
Qté.	120 Pièce
Emballage	Tablette (assemblage à la main)

RJ45C5 T1V 4.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E471884

Dimensions et poids

Profondeur	16.7 mm	Profondeur (pouces)	0.6575 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0.7874 inch
Hauteur version la plus basse	16.5 mm	Largeur	16 mm
Largeur (pouces)	0.6299 inch	Poids net	6.45 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

Propriétés électriques

Rigidité diélectrique, contact - blindage	1500 V DC	Rigidité diélectrique, contact - contact	1000 V DC
Résistance de passage	<25 mΩ	Résistance d'isolation	≥ 500 MΩ
Tension nominale	125 V	Courant nominal	1.5 A
PoE / PoE+	selon IEEE 802.3at		

Standards

Norme de connecteur IEC 60603-7-51

Caractéristiques du système

Nombre de pôles	8	LED	Non
Longueur du picot à souder (l)	4 mm	Montage sur le circuit imprimé	Raccordement soudé THT
Pas en pouces (P)	0.050 "	Matériau de blindage	Laiton
Blindage	Oui	Fermeture latérale, propriété	Brides à souder
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)	± 0,1 mm	Nombre de picots par pôle	1
Type de raccordement	Raccordement soudé	Diamètre du trou d'implantation (D)	0.9 mm
Catégorie	Cat. 5	Famille de produits	Données OMNIMATE - Prise modulaire RJ45
Pas en mm (P)	1.27 mm	Degré de protection	IP20
Cycles d'enfichage	750	Angle de sortie	180°
Surface de blindage	nickelé	Languettes de blindage	aucun
Catégorie de puissance	Cat. 5	Système de soudure	Soudure manuelle, Soudure à la vague
Dimensions du picot à souder	octogonal	Tolérance sur la position du picot à souder	± 0,1 mm

RJ45C5 T1V 4.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Données des matériaux

Matériau isolant	PA 6T	Couleur	noir
Tableau des couleurs (similaire)	RAL 9011	Groupe de matériaux isolants	II
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)	≥ 500	Résistance d'isolation	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)		Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau de base du contact	Bronze phosphoreux	Matériau des contacts	Alliage de cuivre
Surface du contact	Or sur nickel	Structure en couches du contact mâle	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Température de stockage, min.	-40 °C	Température de stockage, max.	85 °C
Température de fonctionnement, min.	-40 °C	Température de fonctionnement, max.	85 °C

Emballage

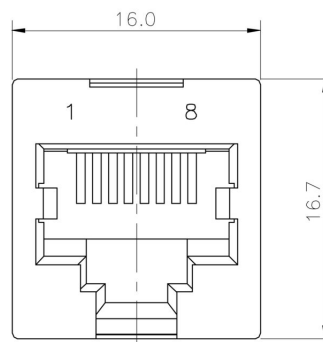
Emballage	Tablette (assemblage à la main)	Longueur VPE	317.00 mm
Largeur VPE	191.00 mm	Hauteur VPE	67.00 mm

Note importante

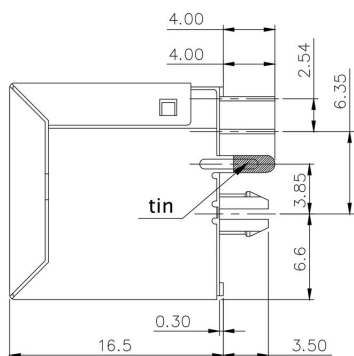
Remarques

Dessins

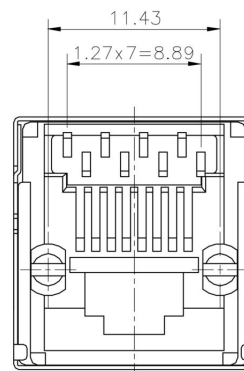
Dessin coté



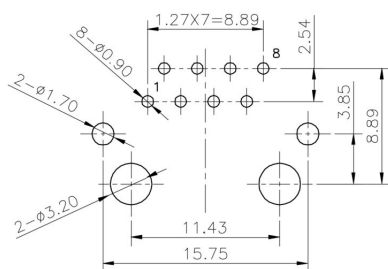
Dessin coté



Dessin coté



Conception de la plaque de circuit imprimé



PCB LAYOUT

RJ45C5 T1V 4.0N4N TY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

RJ45	G1	R	1	U	3.2	E	4	GY/GY	TY	RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY																											
										<table><tr><td>Packaging</td><td>TY RL</td><td>Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)</td></tr><tr><td>LED</td><td>Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N</td><td>Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED</td></tr><tr><td>Contact surface thickness</td><td>4</td><td>1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"</td></tr><tr><td>EMI tabs (ground fingers)</td><td>E N</td><td>E = with EMI tabs N = without EMI tabs</td></tr><tr><td>Solder Pin length</td><td>3.2 1.6 D</td><td>3.2 mm 1.6 mm SMD</td></tr><tr><td>Direction, latch style</td><td>U D V Y</td><td>Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up</td></tr><tr><td>Number of Ports</td><td>1 12; 14; ... 21; 41; ...</td><td>1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel</td></tr><tr><td>Assembly on PCB</td><td>R S T</td><td>Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave</td></tr><tr><td>Performance Category</td><td>C5 C6 C6A C6e M G1 G10 U MP MP+</td><td>Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+</td></tr></table>	Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)	LED	Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED	Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"	EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs	Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD	Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up	Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel	Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave	Performance Category	C5 C6 C6A C6e M G1 G10 U MP MP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+
Packaging	TY RL	Tray in box (manual assembly) Tape on Reel (automated assembly)																																			
LED	Y/G G/Y GY/GY O/G R/O ... N	Yellow/Green Green/Yellow (standard) Green-Yellow/Green-Yellow Orange/Green Red/Orange ... (further combinations possible) without LED																																			
Contact surface thickness	4	1 = 3µ", 2 = 6µ", 3 = 15µ", 4 = 30µ", 5 = 50µ"																																			
EMI tabs (ground fingers)	E N	E = with EMI tabs N = without EMI tabs																																			
Solder Pin length	3.2 1.6 D	3.2 mm 1.6 mm SMD																																			
Direction, latch style	U D V Y	Horizontal (90°, side entry), latch up Horizontal (90°, side entry), latch down Vertical (180°, top entry) Diagonal (45°), latch up																																			
Number of Ports	1 12; 14; ... 21; 41; ...	1 Port multi ports side by side, Multiport multi ports about each other, Multilevel																																			
Assembly on PCB	R S T	Through Hole Reflow - THR Soldering process: Wave or Reflow soldering Surface Mount Technology - SMT Soldering process: Reflow soldering Through Hole Technology - THT Soldering process: Wave																																			
Performance Category	C5 C6 C6A C6e M G1 G10 U MP MP+	Category 5 Category 6 Category 6A Category 5e 10/100 Mbit 10/100/1000 Mbit 10 Gbit Unshielded 10/100 Mbit with POE 10/100 Mbit with POE+																																			

Légende